

3月13日暫定プログラム

会場	分野	プログラムNO	開始時間	終了時間	講演選択	発表者	所属	演題名
A	バウンダリスキャン技術	13A1-1	10:50	11:05	論文発表	有元 康滋	徳島大学大学院	待機モードICからの配線テスト可能なバウンダリスキャン設計についての検討
		13A1-2	11:05	11:20	論文発表	馬 竣	愛媛大学	ワンタイムパスワードによるJTAGアクセス認証アーキテクチャのFPGA実装と性能評価
		13A1-3	11:20	11:35	論文発表	土屋 秀和	東海大学大学院	メモリデバイスのテストパターン生成に着目したバウンダリスキャンテストの検討
B	配線板とその製造技術 (1)	13B1-1	9:30	10:00	依頼講演	熊谷 博之	メルテックス(株)	ビアフィリングめっきの最新技術動向
		13B1-2	10:00	10:30	依頼講演	文蔵 隆志	(株) JCU	セミアディティブプロセスにおける微細配線対応シード層エッチング
	配線板とその製造技術 (2)	13B2-1	10:50	11:05	論文発表	有本 太郎	ウシオ電機(株)	Xe*2エキシマランプを用いためっき膜と基材の密着性向上とメカニズム解析
		13B2-2	11:05	11:20	論文発表	阿久津 歩	宇都宮大学	ガルバニック腐食抑制型エッチング液のエッチングプロセス解析
		13B2-3	11:20	11:35	論文発表	中 亮太	奥野製薬工業(株)	PRパルス電解を用いた接着信頼性の高い粒状銅めっき皮膜の形成
		13B2-4	11:35	11:50	論文発表	小寺 南渡	宇都宮大学	エレクトロニクス実装分野におけるウイスキー発生に関する研究
		13B2-5	11:50	12:05	論文発表	本間 秀和	奥野製薬工業(株)	「高出力 DUV ビコ秒パルスレーザーと高信頼性の無電解/電気 Cu めっき技術を組み合わせたファインマイクロビアの形成」
C	プリンタブル・フレキシブルデバイス実装	13C1-1	10:50	11:05	論文発表	加藤 えみり	法政大学	発光補助ドーパント添加による黄色マイクロ流体電気化学発光素子の特性向上
		13C1-2	11:05	11:20	論文発表	倉浪 大輝	法政大学	マイクロ流体有機ELへの正孔注入改善の検討
		13C1-3	11:20	11:35	論文発表	小林 愛佳	法政大学	ニードル式ディスペンサによる電子注入層の成膜と電気化学発光評価
		13C1-4	11:35	11:50	論文発表	藤川 真希子	エレファンテック(株)	インクジェットプロセス適用に向けた塩化銀ナノ粒子の開発及び、疑似参照電極製造検討
		13C1-5	11:50	12:05	論文発表	山岡 尚樹	住友金属鉱山(株)	ポリオール法を用いた低温焼結用銅粉の作製